

台灣發明協會 函

機關地址：241608新北市三重區重陽路一段1號4樓之11

承辦人：秘書處 吳秋瑾

電話：02-66057626

電子信箱：tia7626@yahoo.com.tw

受文者：國立臺北大學

發文日期：中華民國114年5月12日

發文字號：台發協字第1140005002號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：2025年美國矽谷國際發明展 邀請函、報名表、切結書(ATTCH1 A095G0000Q0000000_0005002A00_ATTCH1.pdf、ATTCH2 A095G0000Q0000000_0005002A00_ATTCH2.doc、ATTCH3 A095G0000Q0000000_0005002A00_ATTCH3.doc)

主旨：敬邀 2025年美國矽谷國際發明展，請協助轉知師生踴躍報名參加。

說明：

- 一、2025年美國矽谷國際發明展(Silicon Valley International Invention Festival 2025)訂於2025年8月8日~8月10日於美國聖克拉拉會議中心舉行(USA, California, Santa Clara Convention Center)。
- 二、主辦單位：國際發明聯盟協會(IFIA)。台灣授權單位：台灣發明協會。本屆展覽競賽獎項豐富，包含大會首獎、國際大會特別獎以及金牌、銀牌、銅牌等獎項。
- 三、即日起接受報名至2025年6月底截止。(請參考附件)
- 四、報名相關問題歡迎洽詢本會承辦人：秘書處 吳秋瑾小姐。電話：(02)6605-7626。電子郵件：tia7626@yahoo.com.tw。歡迎透過Line官方好友：@tia1972 與我們聯繫。

正本：中華台北著作權人協會、國立臺灣海洋大學、國立政治大學、國立臺灣大學、國立臺灣大學計算機及資訊網路中心、國立臺灣師範大學、國立陽明交通大學、國立臺北藝術大學、國立臺北教育大學、臺北市立大學、東吳大學、中國





文化大學、世新大學、銘傳大學、實踐大學、大同大學、臺北醫學大學、康寧學校財團法人康寧大學、國立臺灣戲曲學院、國立臺北護理健康大學、國立臺北商業大學、國立臺北大學、國立臺灣藝術大學、馬偕學校財團法人馬偕醫學院、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、淡江大學學校財團法人淡江大學、華梵大學、真理大學、國立體育大學、國立中央大學、中原大學、長庚大學、元智大學、開南大學、國立清華大學、玄奘大學、中華大學學校財團法人中華大學、國立聯合大學、國立臺中教育大學、國立臺灣體育運動大學、國立中興大學、國立中興大學計算機及資訊網路中心、東海大學、逢甲大學、靜宜大學、中山醫學大學、亞洲大學、國立彰化師範大學、大葉大學、明道學校財團法人明道大學、建國科技大學、國立暨南國際大學、國立嘉義大學、國立中正大學、南華大學、國立臺南藝術大學、國立臺南大學、台灣首府學校財團法人台灣首府大學、中信學校財團法人中信金融管理學院、長榮大學、國立中山大學、國立高雄師範大學、國立高雄大學、義守大學、高雄醫學大學、國立屏東大學、國立金門大學、國立宜蘭大學、佛光大學、國立東華大學、慈濟學校財團法人慈濟大學、國立臺東大學、國立空中大學、高雄市立空中大學、佛教慈濟醫療財團法人關山慈濟醫院、佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院、佛教慈濟醫療財團法人玉里慈濟醫院、佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院、佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院、佛教慈濟醫療財團法人斗六慈濟醫院、佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院、板橋國泰醫院、輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院附設居家護理所、輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院、亞洲大學附屬醫院、國泰醫療財團法人國泰綜合醫院、國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院、國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院、國立嘉義大學附設實驗國民小學、高雄榮民總醫院、臺北榮民總醫院、恩慈美國學校、新竹美國學校、桃園美國學校、國立成功大學、奇美醫療財團法人奇美醫院、奇美醫療財團法人佳里奇美醫院

副本：114/05/13
08:01:59

理事長 張家菊



2025 年第 4 屆美國矽谷國際發明展

邀 請 函



發明先進：敬啟

美國是我國最大的貿易市場，每當有新產品問市，莫不以進入美國市場為第一考量，今年美國 SVIIF 即將在八月開展，本會將組團參加，盼有新產品之發明人或廠商，欲獲取美國市場者，美國矽谷國際發明展將是一項最佳選擇，想藉由參加此大展吸取經驗者，千萬不要錯失這一年一度的發明展出盛會。

往年美國發明展展出時，全球各地工商人士都前往參觀，各國新聞媒體均前往採訪報導，您有可能一夕之間舉世聞名，又可觀摩世界各國發明家的新作品以予學習改進參考，一舉數得。

今年我們除了傳承以往的優點外，本屆展覽預計有廿餘國參展，敬盼與您同行。

2025 年 SVIIF 於 8 月 8 日~10 日開展

假聖克拉拉會議中心舉行

即日起接受報名至 6 月底截止



台灣發明協會
美國矽谷參展團

團長 張家菊 敬邀

SIF 2025 美國矽谷國際發明展-參展辦法

- 一、宗旨：為宣揚我國工業技術能力、促進國際科技交流、爭取國家榮譽、增進國民外交、拓展發明新產品海外市場及提高新產品之行銷市場價值。
- 二、主辦單位：國際發明聯盟協會(IFIA)
- 三、台灣授權單位：台灣發明協會
- 四、團名：2025 美國矽谷國際發明展-台灣參展團
- 五、依據：美國矽谷國際發明展大會組團授權書
- 六、展覽會名稱：Silicon Valley International Invention Festival 2025
- 七、展出日期：2025 年 8 月 8 日~8 月 10 日
- 八、展出地點：USA, California, Santa Clara Convention Center

5001 Great America Pkwy, Santa Clara, California 95054, United States

九、費用：

1. 參展費：每件作品**\$60,000 元**
(包含報名費、展位費、評審費、入場證、1 桌 2 椅及電源費)
2. 海報費：每件**\$1,000 元**(自理者免繳)
3. 代展費：每件**\$10,000 元**
4. 個人旅費：**另計**
5. 作品攤位由協會安排，如需獨立攤位則需另加攤位費**\$30,000 元**
6. 現場中英翻譯人員 160 美元/日(請自行交付翻譯人員，本會不代收。)

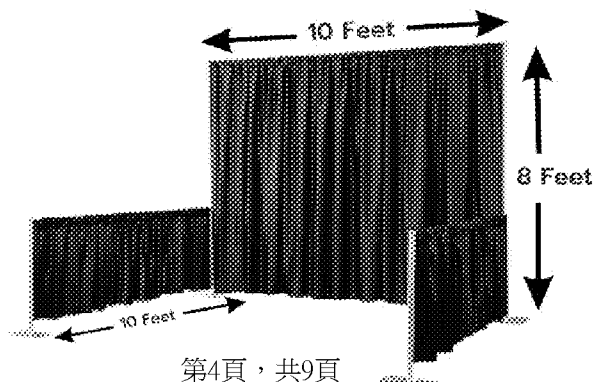
十、即日起接受報名至 2025 年 6 月底截止。

※ 截止日前資料未繳交齊全者將無法刊登於矽谷展覽大會專刊。

※ 指定轉角攤位者須另加台幣 10,000 元。(有預訂並繳款者優先)

※ 素食者或需住單人房(另加台幣_____元) 者也請於隨團報名表裡標註。

攤位示意圖：



繳交參展資料明細單：

請以電子檔交件：tia7626@yahoo.com.tw

寄件主旨請輸入□□□(個人名、學校名或公司名)報名美展。

文字部分請交 **word** 檔，照片圖檔請以 **jpg** 檔交件，每件作品請獨自建立一個資料夾，報名一件以上之作品，請於資料夾上輸入編號，以便雙方核對或通知補件，謝謝。

- ☐1. 已填妥之報名表(一件作品填寫一份報名表，需詳細填寫完整)
含產品介紹中、英文(約 150 字左右)
- ☐2. 參展切結書(請由該件作品一位發明人代表簽名或蓋章)
- ☐3. 參展品專利證書檔案或申請中收據(無專利者免附)
- ☐4. 參展品照片檔案(每件作品建議提供二張)
- ☐5. 隨團前往參展人員請附上隨團參展表(含護照影本)
- ☐6. 自行前往參展人員請提供人數及中英文姓名
- ☐7. 發明人或聯絡人名片
- ☐8. 聘請翻譯人員切結書(無聘請者免填)

報名日期：即日起接受報名至 6 月底截止

聯絡地址：(241-608)新北市三重區重陽路一段 1 號 4 樓之 11

聯絡人：秘書處 吳秋瑾 小姐

聯絡電話：02-6605-7626

E-mail：tia7626@yahoo.com.tw

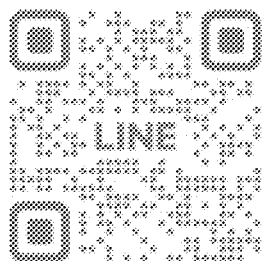
- 參展資料請連同全額參展費於報名截止日前繳交至本會，以完成報名手續。
(以上資料未齊全或未繳付全額參展費者，歉難受理報名。)



- 電匯資料：新光銀行(銀行代碼 103) 北三重分行

戶名：“**社團法人台灣發明協會**”。 帳號：“**0310-10-100304-3**”。

@tia1972



台灣發明協會
官方好友 LINE

發明人姓名 上限 10 位 請勿修改表格	發明人填寫姓名注意事項：範例：王小明 Wang Hsiao-Ming ※此欄為若得獎，獎狀上的得獎者姓名，一位以上之發明人，請一律填寫於此，資料一旦送出，不得變更修改。 (中) (護照英文名)		
公司/學校名稱	(中) (英)	統一編號	
聯絡地址	(中) (英)		
電話		手機	
E-mail		http://	
聯絡人	姓名： 職稱： 電話： E-mail:	參展品類別 (請參閱選項 填入一編號)	
隨團參展	☐ 是，共__人。 (請先繳交護照影本) ☐ 不跟團，共__人自行前往。(請提供名單) ☐ 委任協會代理。(另加代展費 10,000 元/件)		
台灣專利	☐ 發明__號 ☐ 新型__號 ☐ 設計__號		
專利名稱		☐ 公告中案號__號 ☐ 申請中案號__號	
展品名稱	(中) (英)		
展品介紹	展品介紹(簡單扼要中英文各約 150 字左右)		

(一件作品填寫一份報名表，需詳細填寫完整，作品照片請勿貼在此，以利作業，謝謝。)

CLASS - CHECK THE CATEGORY OF YOUR INVENTION (產品種類)

A	Mechanics(機械學) / Engines(引擎) / Machinery(機械) / Robotic(機器人學) / Tools(工具) / Industrial process(工業生產流程) / Metallurgy(冶金學)
B	Electronics(電子) / Electricity(電力) / Methods of Communication(電力通信方法)
C	Building(建築) / Architecture(建築學) / Civil Engineering(土木工程) / Construction(建造) / Materials(材料) / Woodwork(木工)
D	Sanitation(公共、環境衛生) / Ventilation(通風設施) / Heating(暖氣)
E	Security(安全) / Rescue(救援) / Alarm(警報裝置)
F	Housekeeping(家務管理) / Nutrition(營養學)
G	Commercial, Industrial and Office Equipment(商業、工業以及辦公室的設備)
H	Agriculture(農業) / Forestry and Garden(林業及園藝) / Pet and Farm Animal Supplies(寵物及家畜相關產品)
J	Traffic(交通) / Transport(運輸) / Car Accessories(汽車用品)
K	Graphic Arts(平面藝術) / Advertising(廣告)
L	Games(遊戲) / Sport(運動) / Hobbies(嗜好)
M	Medical Technology(醫藥科技) / Medical Engineering(醫學工程) / Medicine(藥品) / Hygiene(衛生)
N	Hardware(硬體) / Software(軟體) / Cybersecurity(網路安全) / Blockchain(區塊鏈) / Internet of things (IoT)(物聯網)
O	Teaching Research(教學研究) / Pedagogical Items(教學項目)
P	Energy(能源) / Renewable and green energy(再生及綠色能源)
Q	Paramedical(輔助醫療) / Health(健康) / Foodstuffs(食品) / Drinks(飲品) / Cosmetics(化妝品)



切 結 書

※一份作品請一位發明人代表填寫一份切結書



本人(公司)參加 2025 美國矽谷國際發明展，其報名表內填寫之所有內容，皆已再次確認無誤，同意報名表送出後，不得再做任何修改變更，含若得獎的得獎證書亦同。

同時願意遵守大會一切規定，並絕對尊重大會國際裁判的評審結果，絕無異議。



立書人

姓 名： (簽/蓋章)

身分證字號：

住 址：

電 話：

作品名稱：

中華民國 年 月 日

